

第 78 期

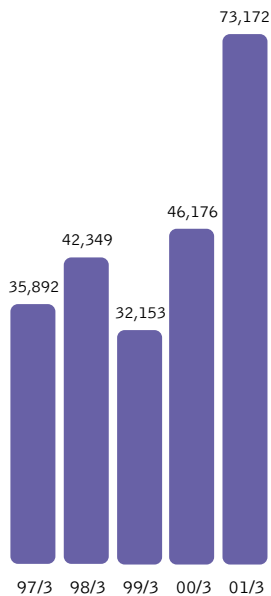
事業報告書



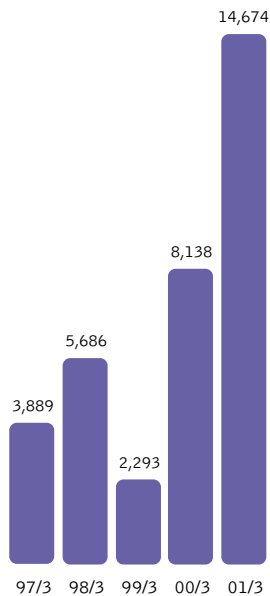
株式会社東京精密

財務ハイライト

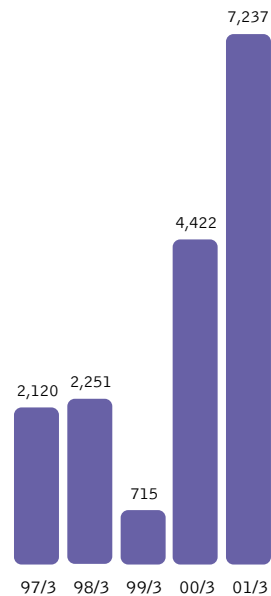
連結売上高(百万円)



連結経常利益(百万円)



連結当期利益(百万円)



単位:百万円

	1997/3	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3
連結売上高	35,892	42,349	32,153	46,176	73,172
連結経常利益	3,889	5,686	2,293	8,138	14,674
連結当期利益	2,120	2,251	715	4,422	7,237
連結総資産	42,257	46,163	41,309	61,007	91,477
連結純資産	18,502	27,604	28,437	33,433	38,779
発行済株式総数(千株)	32,188	36,575	37,004	37,543	37,465
1株当たり当期利益(円)	65.89	63.87	19.41	118.43	192.95

1株当たり当期利益は、期中の平均株式数により算出しています。

株主の皆様へ

東京精密の株式を保有して頂き、有難う存じます。厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、株主の皆様が当社株式を保有していただいた目的に沿った経営を目指しております。

当社は、経営指標といたしましては、一株当たりの純利益（EPS）を長期的に増大させていく事を重視しております。会社にとっては、企業価値を長期的に増大させることになりましますし、株主の皆様のご期待に応えることになると考えます。これは当社のモットーであるWIN-WINの関係を株主の皆様と会社との間で作り上げる事につながると確信しております。

当社は、技術指向型の会社です。上記の目的のために当社は次の「製品開発の原則」に沿って技術開発を継続的に行ってまいります。

1. 世界No. 1の製品を創る。

マーケットシェアNo. 1の商品は

（1）好況時は、利益の極大化を図れる。

（2）不況時は、損失の極小化を図れる。

2. 研究開発投資は自己資金で。

3. 技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。

4. 市場規模が停滞縮小傾向にあるが、ユーザーとの関係で、今後もR&D投資が必要な製品は、競合先であってもアライアンスを組み、R&Dコストをシェアする。



この原則を守るためには、各国、各社の持つ異文化を包摂したグローバルかつハイブリッドな東京精密の文化風土を醸成しなければなりません。そこで、「WIN-WINの仕事で世界No. 1の商品を創ろう」というモットーを制定し、世界No. 1の商品開発体制の構築に努めてまいりました。

さらに、本年1月には「ACCRETECH(アクレーテク)」というコーポレートブランドを導入しました。「ACCRETECH」は、共に成長するという意味の「ACCRETE」と「TECHNOLOGY」を組み合わせた合成語で、「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して、世界No. 1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく」という当社の企業理念を一語で表したものです。

株主の皆様にも是非当社の企業理念にご賛同賜り、このコーポレートブランド「ACCRETECH」のもと、更なる飛躍を目指す当社に、今後とも格別なるご理解とご支援をお願い申し上げます。

大坪 英夫

代表取締役社長

代表取締役社長

大坪 英夫

'88

経営改革草創期

世界No. 1シェア獲得を目指し、世界初の自動針合わせ機能をはじめ、数世代先を見据えた製品コンセプトに基づいて、「A-PM-90A」の開発は進められました。



ウェーハプロ - ビングマシン
「A-PM-90A」

'93

整備期

東京精密とカールツァイス社のWIN-WINな協力関係により、計測分野での世界No. 1のポジションを確立しました。また、この協力関係は、半導体製造装置分野にも拡大しています。

1995年10月 提携契約調印式にて握手する大坪英夫 東京精密代表取締役社長とDr.-Ing. Peter H. Grassmann カールツァイス社理事長(当時)



東京精密は、めまぐるしく変化する経営環境の中、様々な経営施策を実行し、成長への基礎固めを行ってきました。当社は、21世紀を迎え、技術・知恵・情報を融合し、大胆な企業成長を目指します。

'88

経営改革草創期

当社は、1988年より現在の経営の根幹ともいえる「グループリーダー制」を導入しています。この制度は、製品別技術グループ制による製品開発体制のもと、各グループのリーダーが、製品開発のみならず、製品の業績や事業計画、設備投資、人員計画など、多岐にわたって責任を持つというものです。グループリーダーは、社長と直結しているため、この制度は、経営の動向を左右する開発計画などの意思決定が非常にスピーディーに行えるという大きな利点を備えています。

'93

整備期

この時期、当社は、各グループの主力製品の市場での位置付けを確認し、製品の選択と集中を実施しました。半導体製造装置分野では、マーケットシェア世界No.1獲得を目指して開発したウェーハプロ - ビングマシン「A-PM-90A」を市場投入し、拡販に努めました。また、変動が激しい半導体のビジネス環境(シリコンサイクル)に対応できるフレキシブルな生産体制も確立し、不況時であっても収益が出せる体制を構築しました。

計測製品については、成長分野に経営資源を集中させ、その他の分野については、アライアンス・アウトソースを活用し、ビジネスの合理化を図るという経営方針に沿って、1995年、競合メーカーであったドイツのカールツァイス社と精密測定機器分野で全面提携をいたしました。双方の強味を活かし、製造販売を協力して行っています。

'96



ウェーハ外觀検査装置
「WIN WIN 50」

離陸準備期

「WIN-WIN 50」は、当社のモットーを実践し、世界No. 1の製品を創りたいという共通の目的を持った個人及び会社と「WIN-WIN」の協力関係を築き、開発されました。

'00



次世代リソグラフィ装置
「LEEPL」

テイクオフ期

「LEEPL」は、シンプルな構造、高い信頼性、高いスループット、マスクデザインの容易性及び装置コストの低減化に貢献する装置として、期待されています。

'96

離陸準備期

当社の業績を継続的に拡大していくために重要なことは、強い製品開発体制の維持と適正な製品開発基準を持つことです。そのため1997年、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑え、高成長・高収益なビジネス基盤構築を前提とした「製品開発の原則」を当社の経営の大原則として制定しました。

一方、当社の業績は、ウェーハプロ - ビングマシン「A-PM-90A」の販売拡大とともに、順調な成長を遂げました。当初、10%未満であった当社のウェーハプロ - ビングマシンのマーケットシェアは、過半数を超えるまでになりました。

また更なる業績拡大を目指し、技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い新しい分野の製品開発に積極的に取り組みました。

'00

テイクオフ期

21世紀の飛躍を目指し開発を進めてきました新規参入製品ウェーハ外觀検査装置、ポリッシュ・グラインダを2000年度に市場投入し、販売を開始いたしました。2001年度には、CMPを市場投入いたします。

また、新たに「LEEPL」という次世代リソグラフィ事業にも着手いたしました。リソグラフィは、半導体製造前工程において中核となるプロセスです。デザインルール100ナノメートル(0.1 μ)以下の次世代装置の完成が待望される中、「LEEPL」の製品化は、業界で注目を浴びています。

今後、これら新製品ビジネスの乗軌化に注力し、業績の拡大に努めるとともに、2001年1月に導入しましたコ - ポレートブランド「ACCRETECH」の言葉に込めた企業理念に沿った経営を通して、更なる成長に向け邁進してまいります。

営業の概況

1. 当期の概況

業績全般

当期の半導体業界は、下期後半、急速に調整局面に入ったものの、年度全体で捉えると活況を呈し、半導体メーカー各社は、パソコン、携帯電話、ゲーム機器、デジタル家電などの市場拡大に対応するべく、増産を目指し積極的に設備投資を実施いたしました。

当社は、半導体メーカー各社からの受注増に対応し、リードタイムの短縮と大幅な生産能力の増強をはかりました。この結果、主力製品であるウェーハプロービングマシンおよびウェーハダイシングマシンの売上高が、いずれも既往最高を大幅に更新し、半導体製造用機器部門全体の売上高と利益も、ともに既往最高となりました。

計測機器部門につきましても、当期は、主要なお客様である自動車、工作機械の各メーカーの設備投資が堅調でありました。当社は、小型化・高精度化の顧客ニーズに対応するとともに、着実な営業努力と生産面でのコストダウンを推進した結果、前期対比増収増益となりました。

この結果、当グループの当期の連結売上高は、731億72百万円、連結経常利益は、146億74百万円、連結当期純利益は、72億37百万円となりいずれも既往最高となりました。

各部門の概況

〔半導体製造用機器部門〕

半導体各メーカーの設備投資ニーズに積極的に対応し、営業努力を重ねた結果、売上高は、585億26百万円、営業利益は、120億39百万円となり、既往最高を更新しました。

主力製品のウェーハプロービングマシンでは、高剛性を特徴とする新機種「UF200S」

が、お客様から高い支持を得て、最先端の生産ラインに順調に出荷されています。当期は、受注の急増に際し、過去最大の月産300台体制を構築し市場拡大に対応しました。

また、ウェーハダイシングマシン「A-WD-200T」¹、「A-WD-300T(300mm対応)」²につきましても、生産性の高いマシンとして機能を高く評価され、前期比、大幅な売上増となり、当社の基軸製品の一つに成長しつつあります。

新製品のウェーハ外観検査装置「WIN-WIN 50」とポリッシュ・グラインダ(ウェーハ裏面研磨装置)「PG200」は今年より予定通り売上計上となり、業績進展に寄りました。

研究開発におきましては、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に努めました。その成果として、関係会社の株式会社リープルが、100nm～50nmの微細回路製造用露光装置の技術を確立し、LEEPL電子ビームリソグラフィ装置及びマスク製造並びにマスク検査装置の実用化に目途をつけました。今後、これらの製品群が東京精密のコア製品に成長していくものと考えております。

〔計測機器部門〕

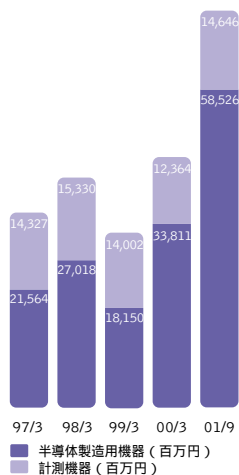
当期、自動車および工作機械メーカーの需要は増加傾向にあり、積極的な営業推進の結果、売上高は、146億46百万円、営業利益は、29億92百万円となり前期比増収増益を達成しました。

自動計測機器では、真円度測定機能を付加したアンブ「パルコムV10」が伸長しました。また、汎用測定機では、高精度で好評の表面粗さ測定機「サーフコム3000A」や世界最高精度を誇る真円度測定機「ロンコム65A」の売上が増加しました。

八王子新本館の竣工と新工場用地取得

かねて八王子工場内に建設しておりました八王子新本館(11階建て、延べ9,532m²)が、2001年3月末に竣工いたしました。新本館には、半導体製造用機器部門の開発グループが業務を開始いたしましたほか、半導体営業グループも、5月上旬新本館に移転いたしました。今後、開発、製造、販売および保守管理が同じ八王子地区で業務を展開することとなりますが、このような一貫体制は業界内でも数少なく、顧客サービスの充実とスピードアップに寄与するものと確信しています。

連結部門別売上高



また、当社は、同じく2001年3月に、八王子工場に近接するJR北八王子駅前に新工場用地(約14,600m²)を取得いたしました。この工場用地は、関係会社の株式会社リーブルで開発中のLEEPL電子ビームリソグラフィ装置の量産工場をはじめ、新製品の開発、生産に活用する予定です。

連結キャッシュフローについて

当期の営業、投資キャッシュフローは、上記記載の営業活動の大幅拡大と投資活動の増大により、マイナスとなり、財務活動により補いました。しかし、今後1～2年しますと、既存製品に加えて新製品が貢献し、営業活動によるキャッシュフローは大幅に好転する見込です。また投資活動も平準化してくることにより、フリーキャッシュフローは大幅な余剰となり、財務活動によるキャッシュフローは減少し、より良い財務状況を構築できる見込です。

2. 次期の見通し

2001年度の半導体市場は前年の活況とは一変して調整局面にあります。海外も含む当社主要取引先の半導体メーカー各社は、操業度が低下しており、設備投資につきましても、先端技術開発などを除き、顕著な抑制を行っております。各社の操業度及び設備投資の回復は予断を許さず、かなりの時間を要するものと懸念しております。

当社は、かかる市場環境を相当に厳しく認識しており、ウェーハブローピングマシンなどのマーケットシェアの高い既存製品に関しましては、300mm対応機などの高機能機種で業績進展に努めるものの、前期比かなりの減収は避けられないと予想しております。

しかしながら、半導体製造用機器部門につきましても、現在も積極的に行われているR&Dつまり先端技術開発投資向けに、ウェーハ外観検査装置やポリッシュ・グライндаなどの当社の新製品群が、2001年度より本格的に売上、利益に貢献し、既存製品の減少を補っていく予定です。従いまして、厳しい調整局面におきましてもその影響を最小限にとどめることができ、業界内で水準以上の業績を確保できるものと考えております。

一方、計測機器部門につきましては、当社が開発してまいりました製品群が、市場において高い評価を確立しつつあり、次期についても当期とほぼ同水準の業績を計上できる見通しです。

以上のような予測のもと、2001年度は、連結売上高600億円(前期比18.0%減)、連結経常利益75億円(前期比48.9%減)、連結当期純利益42億円(前期比42.0%減)と予想しております。

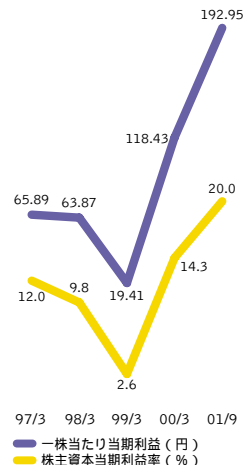
3. 会社が対処すべき課題

当社は、更なる躍進を目指し、半導体製造用機器部門における成長分野の市場に新たに参入すべく、近年新製品の開発に注力してまいりました。それらの新製品のうち、ウェーハ外観検査装置とポリッシュ・グライнда(ウェーハ裏面研磨装置)は2001年3月期に、予定通り売上として計上され、その他の新製品も含めて、今後本格的に業績に寄与する予定です。またLEEPL電子ビームリソグラフィ装置の開発も順調に進んでいます。これらの新製品を計画通り業績に貢献させ、営業基盤の更なる強化と収益体質の確立を目指します。

次に、長期的には成長が確実な半導体市場ではありますが、市況および顧客ニーズの変化にスピーディーに対応できる生産ラインの構築が重要な課題であります。引き続き、社内外のリソースを活用して、より高度な生産システムを構築してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

一株当たり当期利益 (EPS)
株主資本当期利益率 (ROE)



新製品紹介

LEEPL(Low Energy E-beam Proximity Projection Lithography)

LEEPLは、低エネルギーの電子ビームで半導体ウェーハ上に微細回路を焼き付ける新しいタイプの電子ビームリソグラフィ装置です。微細化のデザインルール100ナノメートル以下対応の次世代リソグラフィ装置(露光装置)として、期待を集めています。

製品開発は、(株)リーブル*が担当し、生産は当社が担当します。LEEPLリソグラフィ装置は、電子線リソグラフィ技術と等倍X線リソグラフィ技術という蓄積された技術資産を融合し発展させた装置であるため、巨額の開発投資の必要がありません。そのため、お客様の装置コスト低減にも十分お役に立てる製品となります。また、LEEPL装置を普及させるためには、図



のようなLEEPLのトータルプロセスを提供することが必須となり、並行して推進しております。当社では、マスク検査装置の開発・生産も担当しています。

今年度は試作機を、2002年度に量産機を完成させ、2003年度に本格的な市場投入を計画しています。当社は、LEEPLの開発支援と市場普及に注力していきます。

*(株)リーブルは、当社の事業化支援(49%出資)とNTTアドバンステクノロジー(株)の技術支援を受けて2000年6月に設立されたベンチャー企業。

CMP

CMP装置とは、一口で言えばウェーハ表面の凹凸を研磨して平坦にする装置で、デバイスの微細化による高集積化・高性能化実現のためには、必要不可欠な装置です。例えば、露光装置で微細な配線パターンをウェーハ表面に正確に焼きつけるためには、ウェーハ表面の平坦性が重要です。また、高性能多層配線を実現するために、抵抗の低い配線材料としての銅などの新材料を埋め込む技術としても、CMP装置は活用されています。

市場ニーズを反映し、CMP装置の世界市場は、この1年で倍以上に拡大され、2001年には、2,000億円に達すると予想されるほど大きな市場です。

当社は、長年にわたり培ってきました半導体加工装置とインライン計測の技術を活かし、CMP装置にとって最も重要な基本性能である面内均一性を画期的に向上させた「A-FP-210A」を今期より市場投入し、拡販に努めます。



連結貸借対照表

単位:千円

勘定科目	第77期	第78期	勘定科目	第77期	第78期
	(00.03.31)	(01.03.31)		(00.03.31)	(01.03.31)
	金額	金額		金額	金額
流動資産	46,617,640	69,043,723	流動負債	20,664,650	43,136,614
現金及び預金	6,402,115	6,990,699	支払手形及び買掛金	13,199,590	21,253,111
受取手形及び売掛金	16,357,222	27,253,135	短期借入金	389,000	11,120,000
有価証券	3,732,545		一年以内に返済する長期借入金	380,762	205,592
たな卸資産	18,472,761	32,315,814	未払法人税等	3,584,880	4,862,608
未収消費税等	317,112	807,069	賞与引当金	738,224	1,023,531
繰延税金資産	573,601	1,186,646	その他	2,372,192	4,671,769
その他	859,346	567,918			
貸倒引当金	97,065	77,560	固定負債	6,656,696	9,256,673
固定資産	14,240,556	22,433,053	社債	250,000	250,000
(有形固定資産)	(8,584,276)	(11,243,858)	転換社債	58,000	53,000
建物及び構築物	4,525,933	6,460,170	長期借入金	3,250,612	5,894,184
機械装置及び運搬具	2,254,773	2,348,008	退職給与引当金	2,786,414	
工具器具備品	741,293	792,714	退職給付引当金		2,812,431
土地	810,506	805,337	役員退職慰労引当金	311,668	247,058
建設仮勘定	251,768	837,626	負債合計	27,321,346	52,393,287
(無形固定資産)	(3,927,259)	(6,566,636)			
ソフトウェア	3,780,452	6,419,901	少数株主持分	252,960	304,509
その他	146,807	146,734	資本		
(投資その他の資産)	(1,729,021)	(4,622,559)	資本金	7,011,523	7,014,022
投資有価証券	350,696	2,853,302	資本準備金	11,588,707	11,591,203
長期貸付金	226,014	173,238	連結剰余金	14,836,704	20,401,599
繰延税金資産	582,438	1,120,487	その他有価証券評価差額金		250,830
その他	589,549	520,209	為替換算調整勘定		23,759
貸倒引当金	19,677	44,678	自己株式	3,381	407
繰延資産	456	367	資本合計	33,433,554	38,779,347
社債発行差金	456	367			
為替換算調整勘定	149,206		負債、少数株主持分及び資本合計	61,007,860	91,477,144
資産合計	61,007,860	91,477,144			

連結損益計算書

単位:千円

	第77期(99.04.01~00.03.31)		第78期(00.04.01~01.03.31)	
	金額		金額	
売上高		46,176,076		73,172,461
売上原価		29,707,572		45,375,417
売上総利益		16,468,503		27,797,044
販売費及び一般管理費				
販売費	6,397,742		9,612,934	
一般管理費	1,966,112	8,363,854	3,151,640	12,764,575
営業利益		8,104,649		15,032,468
営業外収益				
受取利息	33,060		60,405	
受取配当金	26,339		77,880	
その他	391,904	451,304	214,728	353,014
営業外費用				
支払利息	88,916		167,147	
その他	328,573	417,490	544,043	711,191
経常利益		8,138,463		14,674,292
特別利益				
退職給付信託設定益			1,732,091	
土地売却益	185,849			
その他		185,849	93,260	1,825,351
特別損失				
退職給付引当金繰入額			2,837,331	
その他	78,847	78,847	558,749	3,396,080
税金等調整前当期純利益		8,245,465		13,103,563
法人税、住民税及び事業税	4,154,802		6,820,980	
法人税等調整額	374,219	3,780,583	1,017,303	5,803,677
少数株主利益		42,665		62,216
連結当期純利益		4,422,215		7,237,669

連結剰余金計算書

単位:千円

	第77期(99.04.01～00.03.31)		第78期(00.04.01～01.03.31)	
	金額		金額	
連結剰余金期首残高	10,755,382		14,836,704	
過年度税効果調整額	762,067	11,517,450		14,836,704
連結剰余金減少高				
配当金	816,573		919,537	
取締役賞与金	54,712		64,890	
自己株式消却額	231,677	1,102,962	688,346	1,672,773
当期純利益		4,422,215		7,237,669
連結剰余金期末残高		14,836,704		20,401,599

連結財務諸表作成の基本となる事項

- 連結の範囲
 - 連結子会社 7社
 - 非連結子会社 4社
- 会計処理基準に関する事項
 - 重要な資産の評価基準及び評価方法
 - 有価証券
 - 子会社株式
移動平均法による原価法
 - その他有価証券
時価のあるもの
連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
 - たな卸資産
主として、商品・製品・材料及び貯蔵品は先入先出法による原価法、仕掛品は個別法による原価法
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
定率法、ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法
 - 無形固定資産
定額法、なお自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
 - 繰延資産の処理方法
 - 社債発行費
支出時に全額費用として処理
 - 社債発行差金
社債償還期間にわたり均等償却
 - 重要な引当金の計上基準
 - 貸倒引当金
債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
 - 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しています。
 - 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しています。
 - 役員退職慰労引当金
役員の退任時に支出が予測される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末支払見込額を計上しています。
 - 重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
 - 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっています。
- 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

連結キャッシュ・フロー計算書

単位:千円

	第77期	第78期
	(99.04.01-00.03.31)	(00.04.01-01.03.31)
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	8,245,465	13,103,563
減価償却費	1,243,181	1,567,207
退職給与 給付 引当金の増加額	5,484	26,016
退職給付信託設定に伴う その他有価証券の減少額		998,069
役員退職慰労引当金の増減額	34,087	64,610
受取利息及び受取配当金	59,400	138,285
支払利息	88,916	211,686
有価証券・投資有価証券売却益	313,945	22,760
有形固定資産除却・売却損益	172,255	8,664
有価証券・ゴルフ会員権評価損	46,784	414,262
英国子会社清算損	32,063	
売上債権の増加額	5,769,602	10,592,331
たな卸資産の増加額	6,624,205	13,640,381
販売用ソフトウェアの増加額	1,153,099	2,550,612
仕入債務の増加額	7,498,876	7,930,838
取締役賞与の支払額	55,500	64,890
その他営業活動による収入(支出)	742,636	918,370
小 計	2,304,215	1,895,193
利息及び配当金受取額	59,400	139,122
利息の支払額	88,916	211,686
法人税等の支払額	741,178	5,555,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,533,519	7,522,829

	第77期	第78期
	(99.04.01-00.03.31)	(00.04.01-01.03.31)
	金額	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	170,000	204,835
定期預金の払出による収入		170,000
有価証券・投資有価証券 の取得による支出	937,759	594,963
有価証券・投資有価証券 の売却による収入	404,043	41,307
有形・無形固定資産の 取得による支出	3,041,280	3,095,326
有形・無形固定資産の 売却による収入	374,416	146,064
貸付金の実行による支出	47,602	888
貸付金の回収による収入	85,331	53,664
その他投資活動による収入(支出)	11,626	12,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,321,225	3,497,940
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(純額)	161,000	10,731,000
長期借入れによる収入	3,200,000	3,000,000
長期借入金の返済	48,503	537,676
社債発行による収入	132,397	
新株引受権の権利行使による収入	799,935	
自己株式の消却による支出	231,677	688,346
配当金の支払	820,502	919,537
その他財務活動による収入	2,649	2,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,873,299	11,588,408
現金及び現金同等物に係る換算差額	212,040	13,890
現金及び現金同等物の増加額	1,297,635	553,748
現金及び現金同等物の期首残高	4,934,479	6,232,115
現金及び現金同等物の期末残高	6,232,115	6,785,863

貸借対照表(単独決算)

平成13年3月31日現在

単位:千円

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	62,773,327	流動負債	39,817,531
現金及び預金	3,863,088	支払手形	15,554,378
受取手形	1,237,134	買掛金	5,654,348
売掛金	26,851,103	短期借入金	10,000,000
たな卸資産	26,170,417	未払金	2,740,340
未収消費税等	796,466	未払法人税等	3,841,028
繰延税金資産	802,304	賞与引当金	727,205
その他	3,060,712	その他	1,300,229
貸倒引当金	7,901		
固定資産	21,991,374	固定負債	7,874,345
(有形固定資産)	(7,952,970)	社債	5,400,000
建物及び構築物	4,595,483	転換社債	53,000
機械装置	1,622,721	退職給付引当金	2,230,730
土地	433,706	役員退職慰労引当金	190,615
その他	663,683		
建設仮勘定	637,374	負債合計	47,691,876
(無形固定資産)	(6,448,751)		
ソフトウェア	6,410,060	(資本の部)	
その他	38,690	資本金	7,014,022
(投資等)	(7,589,652)	法定準備金	12,259,059
投資有価証券	2,764,926	資本準備金	11,591,203
子会社株式	3,195,803	利益準備金	667,855
長期貸付金	167,496	剰余金	18,067,611
繰延税金資産	998,927	別途積立金	5,000,000
その他	498,618	当期末処分利益	13,067,611
貸倒引当金	36,119	(うち当期利益)	(6,688,853)
繰延資産	23,333	その他有価証券評価差額金	244,535
社債発行差金	23,333	資本合計	37,096,158
資産合計	84,788,035	負債及び資本合計	84,788,035

(注) 1. 子会社に対する短期金銭債権	6,333,147千円	6. 自己株式数	58株
2. 子会社に対する短期金銭債務	4,204,239千円	7. 有形固定資産の減価償却累計額	6,777,602千円
3. 子会社に対する長期金銭債権	69,175千円	8. 債務保証及び保証類似行為	18,200千円
4. 子会社に対する長期金銭債務	5,800,000千円	9. 受取手形割引高	4,591,634千円
5. 主な外貨建資産	現金及び預金	332,900千円	10. 役員退職慰労引当金は商法第287条ノ2の引当金であります。
	売掛金	4,190,752千円	
	子会社株式	2,500,996千円	

損益計算書(単独決算)

自平成12年4月1日
至平成13年3月31日

単位:千円

科目	金額	
	内訳	合計
売上高		64,423,655
売上原価		43,752,690
売上総利益		20,670,964
販売費及び一般管理費		
販売費	6,431,406	
一般管理費	2,108,563	8,539,970
営業利益		12,130,994
営業外収益		
受取利息及び配当金	330,232	
その他	782,774	1,113,007
営業外費用		
支払利息	184,999	
その他	116,080	301,080
経常利益		12,942,921
特別利益		
退職給付信託設定益	1,732,091	
その他	87,894	1,819,985
特別損失		
退職給付引当金繰入額	2,629,078	
その他	558,749	3,187,828
税引前当期利益		11,575,079
法人税、住民税及び事業税	5,562,852	
法人税等調整額	676,626	4,886,225
当期利益		6,688,853
前期繰越利益		7,686,268
自己株式消却額		688,346
中間配当額		562,876
利益準備金積立額		56,287
当期末処分利益		13,067,611

(注) 子会社との取引高

(1) 売上高	11,357,758千円
(2) 仕入高	12,992,443千円
(3) 営業取引以外の取引高	99,400千円

利益処分

単位:千円

項目	金額
当期末処分利益	13,067,611
上記の金額を次のとおり処分いたします。	
利益準備金	60,699
配当金(1株につき15円)	561,985
取締役賞与金	45,000
次期繰越利益	12,399,927

(注)平成12年12月1日に562,876千円(1株につき15円)の中間配当を実施いたしました。

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

a 子会社株式 移動平均法による原価法

b その他有価証券

時価のあるもの 当期末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商品・製品・材料及び貯蔵品は先入先出法による原価法、仕掛品は個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

(2) 無形固定資産

定額法、なお自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

3. 繰延資産の処理方法

(1) 社債発行費

支出時に全額費用処理

(2) 社債発行差金

社債償還期間(4年)にわたり均等償却

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付の支払いに備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予測される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末支払見込額を計上しております。

5. リース取引の計上基準

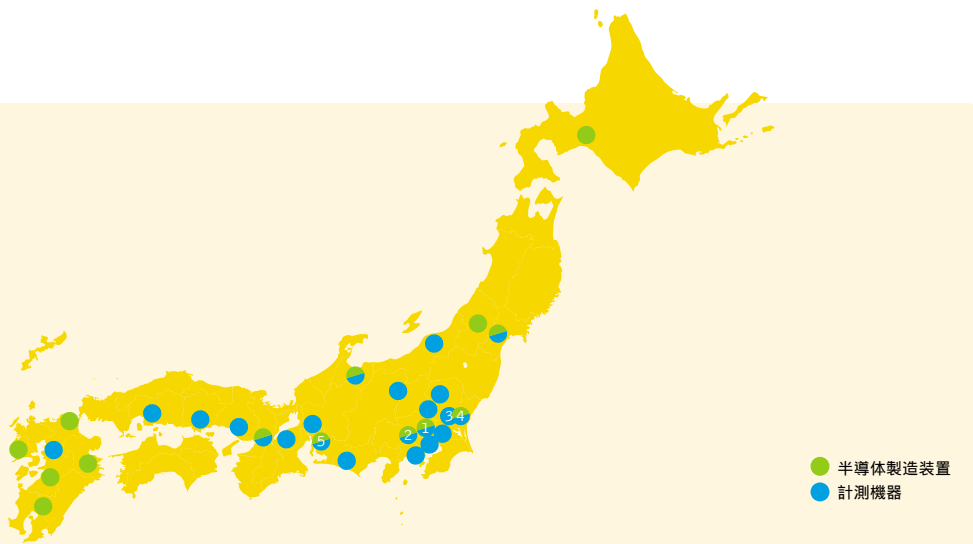
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

ネットワーク

国内主要拠点



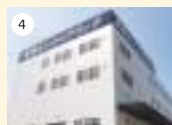
1
本社



2
八王子工場
㈱ティースケイ・マイクロテクノロジー



3
土浦工場



4
㈱東精エンジニアリング
本社・工場

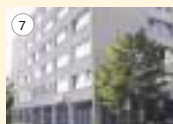


5
㈱東精エンジニアリング
名古屋工場

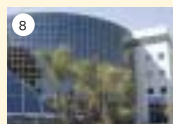
海外拠点



6
TSK America, Inc.



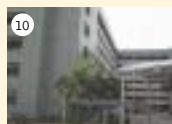
7
Tokyo Seimitsu
Europe GmbH



8
Tokyo Seimitsu
(Israel)Ltd.

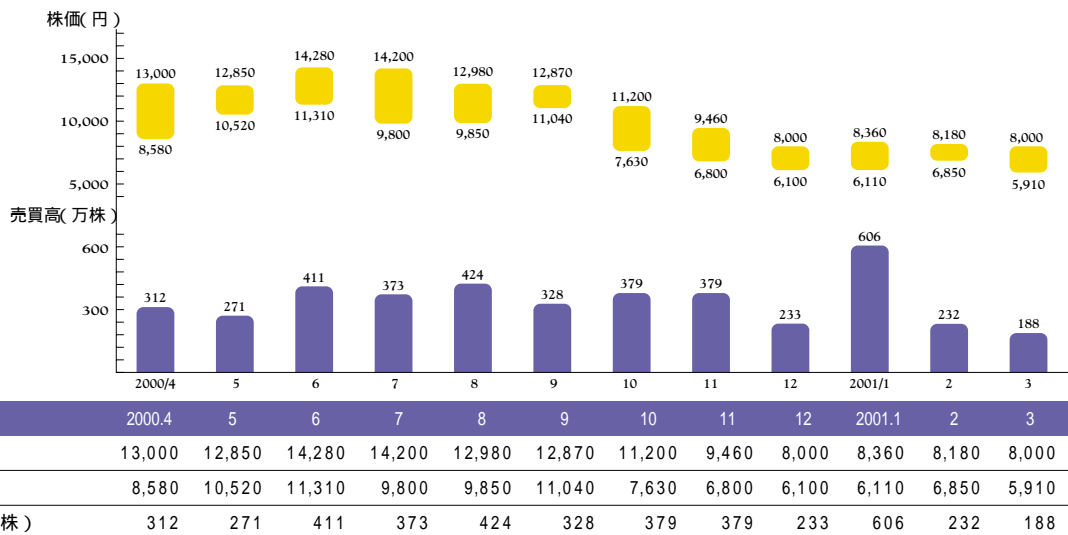


9
Tokyo Seimitsu
(Malaysia)Sdn. Bhd.



10
Tokyo Seimitsu
(Singapore)Pte. Ltd.

株価の推移 (平成13年3月31日現在)



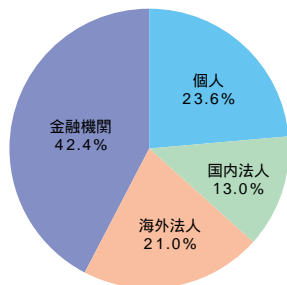
株価の状況 (平成13年3月31日現在)

会社が発行する株式の総数 110,694,100株
 発行済株式の総数 37,465,771株
 当期中の増減

 転換社債の転換による新株発行 2,737株
 利益による自己株式の消却 80,000株

株主数 20,462名

所有者別状況



大株主

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
野村信託銀行株式会社(信託口)	2,272	6.1
東洋信託銀行株式会社	2,138	5.7
三菱信託銀行株式会社(信託口)	1,910	5.1
ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン	1,679	4.5
株式会社富士銀行	1,608	4.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,384	3.7
日本精工株式会社	1,313	3.5
三井生命保険相互会社	1,100	2.9
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.8
安田火災海上保険株式会社	1,001	2.7

東洋信託銀行株式会社の持株数には、信託業務分620千株が含まれております。

会社の概況 (平成13年3月31日現在)

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	事業所	本社 技術研究所 工場	東京都三鷹市 東京都八王子市 八王子(東京都八王子市) 土浦(茨城県土浦市)
設立	昭和24年3月28日	営業所	東北(宮城県仙台市) 山形(山形県山形市) 茨城(茨城県土浦市) 宇都宮(栃木県宇都宮市) 埼玉(埼玉県大宮市) 城東(東京都足立区) 西東京(東京都八王子市) 川崎(神奈川県川崎市) 新潟(新潟県分水町) 厚木(神奈川県厚木市) 北陸(富山県富山市)	長野(長野県岡谷市) 浜松(静岡県浜松市) 名古屋(愛知県三好町) 小牧(愛知県西春町) 京滋(滋賀県守山市) 大阪(大阪府吹田市) 加古川(兵庫県加古川市) 岡山(岡山県岡山市) 広島(広島県広島市) 九州(福岡県久留米市) 九州(大分県大分市)
資本金	7,014,022,762円			
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部			
役員(平成13年6月28日現在)	代表取締役社長 大坪 英夫 代表取締役 米国代表 鴻田 道明 代表取締役 C.O.O.計測主幹 川原 栄次 代表取締役 C.O.O.半導体主幹 鈴木 貞勝 代表取締役 C.T.O.企画主幹 髙 清昭 取締役 高城 英明 取締役 伊勢 徹 取締役 森内 信行 取締役 西嶋 尚生 取締役 林 和博 監査役(常勤) 輕部 昭三郎 監査役 坂田 耕四郎 監査役 野口 光			
従業員数	658名	国内子会社	株式会社 東精エンジニアリング 株式会社 ティーエスケイ・マイクロテクノロジー 株式会社 トーセシステムズ 株式会社 東精クリエイト 株式会社 ティーエスケイ・ファイナンス	
主要取引銀行	富士銀行 本店 東洋信託銀行 日本橋支店 三井住友銀行 本店 あさひ銀行 三鷹支店 東京三菱銀行 新宿中央支店 常陽銀行 土浦支店 関東銀行 本店	海外子会社	TSK America, Inc. Tokyo Seimitsu Europe GmbH Tokyo Seimitsu (Malaysia) Sdn. Bhd. Tokyo Seimitsu (Israel) Ltd. Tokyo Seimitsu (Singapore) Pte. Ltd.	
		国内関連会社	株式会社 リーブル	
		海外関連会社	三門峡中原精密有限責任公司	

株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月中基準日毎年3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
名義書換代理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 東洋信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 東洋信託銀行株式会社 証券代行部 電話(03)5683-5111(代表)
同取次所	東洋信託銀行株式会社
株式取扱手数料	名義書換 無料 新株券交付 無料
公告掲載新聞	東京都において発行される日本経済新聞

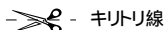
株主の皆様へ アンケートのお願い

弊社では、株主の皆様の声を経営に反映させるべく、アンケートを実施させていただきます。アンケートの質問事項をお読みいただき、回答をご記入の上、ご投函下さい。

皆様のご協力をお願い申し上げます。

弊社資料請求について

弊社資料をご希望の場合は、アンケート用紙の資料請求欄にご記入の上、ご投函下さい。



キリトリ線

株主の皆様へ アンケートのお願い

1. 弊社の株式をご購入された理由は何でしょうか？

- 1) 将来性 2) 収益性 3) 経営理念 4) 事業内容 5) 証券会社に勧められて
6) その他()

2. 今後の弊社株式についてどのような方針をお持ちですか？

- 1) 買い増し 2) 長期保有 3) 売却

また、上記方針を決定するための判断材料は何ですか？

- 1) 株価 2) 配当 3) 将来計画 4) 業績 5) その他()

3. 今回の事業報告書で興味を持たれた記事はどれでしょうか？

- 1) 株主の皆様へ 2) THIS IS ACCRETECH 3) 営業の概況 4) 新製品紹介
5) 財務データ 6) その他()

4. 今後事業報告書で取り上げて欲しいテーマをお聞かせ下さい。

()

5. 株式投資歴をお聞かせ下さい。

- 1) 3年未満 2) 3年以上10年未満 3) 10年以上20年未満 4) 20年以上

6. 所有株式数をお聞かせ下さい。

- 1) 100株 2) 200株以上 3) 500株以上 4) 1,000株以上 5) 5,000株以上

7. 弊社株式保有歴をお聞かせ下さい。

- 1) 1年未満 2) 1年以上 3) 3年以上 4) その他()

8. その他、弊社に対するご意見・ご希望があればお願いいたします。

()

資料請求(ご希望の資料に丸印をお願いします)

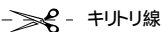
- 1) 会社概要 2) 和文版アニュアルレポート(8月中旬頃発送予定)
3) LEEPL社 会社案内

ご住所

お名前

男性・女性

年齢



郵便はがき

料金受取人払

三鷹局承認

30

差出有効期限
平成13年10月
31日まで

1 8 1 8 7 9 0

東京都三鷹市下連雀9-7-1

株式会社 東京精密
業務部 総務グループ 宛



東京精密ホームページ

<http://www.accretech.jp>



「投資家の皆様へ」をクリック



IRホームページ

<http://www.accretech.jp/contents/ir.html>

最新のプレスリリース掲載

アニュアルレポート、事業報告書等
各種IRツールのダウンロードが可能
な充実したIRライブラリー

決算短信、主要財務指標掲載

決算説明会の状況をオンデマンド
配信(決算説明会后3ヶ月間)

TOKYO SEIMITSU

<http://www.accretech.jp>